

250°C以上での再加熱でも接合保持力を有する、鉛フリー材料

Lead-free materials retain bonding properties even after reheating to 250°C or more

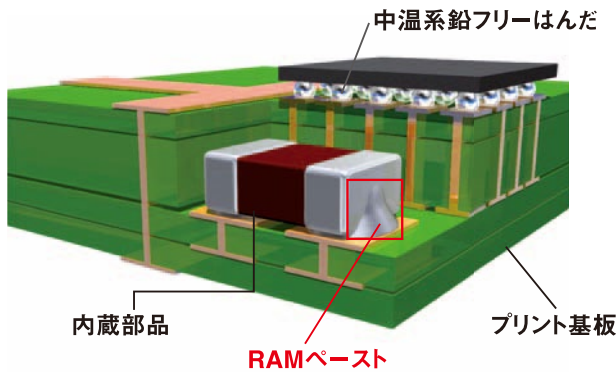
特長

- 鉛フリーはんだのリフロー温度域で接合ができ、同温度での再加熱も可能。
- 鉛フリーはんだでは不可能であったリフロー温度域での再加熱でも接合を保持する。
- 中温系鉛フリーはんだのリフロー温度域で接合が可能。

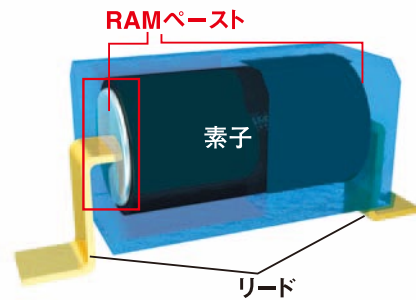
※株式会社日立製作所生産技術研究所様と共同で開発。

用途

部品内蔵基板の内部接合用途



水晶振動子

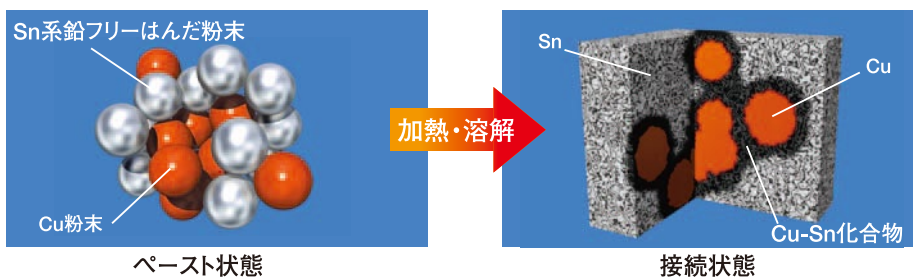


製品仕様

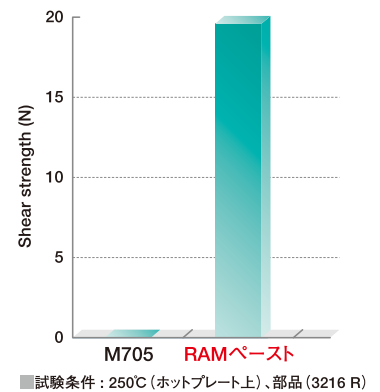
ラインナップ製品

印刷タイプとディスペンス供給タイプの2種類があります。

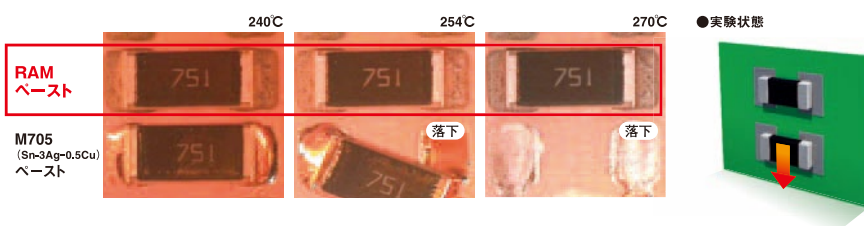
接合概念図



250°Cでのシヤ試験データ



再加熱での保持力比較



ヒートサイクル後のシヤ強度 (3216チップコンデンサ)

